



2025 年 11 月 11 日

各 位

次世代半導体パッケージ向け特殊キャリア「HRDP®」事業化促進

～ 第二ライン稼働開始および協業強化 ～

三井金属株式会社（社長 納 武士 以下三井金属）とジオマテック株式会社（社長 松崎 建太郎 以下ジオマテック）は、三井金属にて開発、ジオマテックにて製造している次世代半導体パッケージ向け特殊キャリア「HRDP®」において、「HRDP®」専用ラインとして設計された第二ラインが稼働を開始した事を受け、両社の協業関係を更に強化する体制へ変更することをお知らせいたします。

次世代半導体パッケージ向け特殊キャリア「HRDP®」は、次世代半導体パッケージを高い生産効率で実現する特殊キャリアであり、ガラス等のキャリア上にスパッタリング法により形成した剥離層と銅層から構成され、主に半導体パッケージ基板等での採用の検討が進んでいます。

2023 年度にジオマテック赤穂工場に投資決定した第二ラインが完成し、まもなく稼働開始となります。第二ラインは、工程の自動化等によりハンドリングに起因する異物の量を大幅に削減し、品質が大きく改善されることが特徴です。これにより顧客からの高い品質要求に応えていきます。また、生産能力はこれまでの 11 万 m²から 16 万 m²に向上いたします。

さらに、第二ラインについて、成膜に使用するスパッタリング装置はジオマテックが投資し、前後工程は三井金属が投資して導入しましたが、両社の協議の結果、スパッタリング装置も三井金属が買取り、資産とすることを決定しました。最先端の顧客からの要求を満たすには、今後もトータルでの設備改善が必要であり、三井金属の持つ生産技術とジオマテックの持つ成膜に関する高いノウハウの連携を図り、いち早く改善するには設備全てを三井金属の資産とする方が適切であると判断したためです。ジオマテックは、生産技術主導の企業へと変革を遂げ、強みである長年培った薄膜技術により工程改善を加速し、三井金属とジオマテックとの協業体制をこれまで以上に強化することで、「HRDP®」の早期事業化を促進していきます。

また、三井金属では、これまで事業創造本部傘下にて HRDP 事業推進ユニットとして開発を進めてまいりましたが、2025 年 10 月 1 日より、機能材料事業本部傘下とし、組織名も「HRDP 事業化推進部」と変更しました。機能材料事業本部は、微細回路形成で世界でも高いシェアをもつ銅箔事業部

や、スパッタリングターゲットを製造しスパッタリングに関する知見を有する薄膜材料事業部が所属しており、これらのシナジーを活用して「HRDP®」の事業化をさらに推進していきます。

三井金属は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で“未来”に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献します。

ジオマテックは、今後とも三井金属向けに安定した品質と生産体制の構築を図ってまいりますとともに、価値ある生産技術と薄膜製品を提供するプロフェッショナルとしての役割を果たしてまいります。

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-5437-8028

Eメール：PR@mitsui-kinzoku.com

ジオマテック 執行役員兼 CSO 榊 大輔

TEL 045-222-5720

Eメール：ir_geomatec@geommatec.co.jp



右 三井金属 納 武士

左 ジオマテック 松崎 建太郎



「HRDP 第一/第二ライン ジオマテック赤穂工場」

「HRDP®」写真



パネルタイプ

300×300mm

310×310mm

415×510mm

510×515mm

600×600mm



ウェハータイプ

Φ300mm